

# DIP生产工艺流程图

工段名称

工段介绍

工艺控制

<b>晶片清洗</b>
利用清洗液与去离子水超洗将晶片表面清洗干净
药水配比 超洗温度 超洗时间

<b>晶片被银</b>
利用掩膜版使用真空溅射的方式赋予晶片电极
电极尺寸 电极牢固度 频率范围 IPQC

<b>点胶固定</b>
使用专用导电胶将晶片与基座连接并固定
导电胶使用条件 针头规格 产品外观 IPQC

<b>胶点固化</b>
使用净化氮气烤箱将导电胶固化
烤胶温度 烤胶时间 烤胶开门条件

<b>频率微调</b>
采用真空蒸发或刻蚀的方法对产品逐一调整频率
微调电极尺寸 电气参数 机台对比 IPQC



<b>包装</b>
将产品包装
数量 标识

<b>激光印字</b>
使用激光在产品上盖丝印客户要求的标示
印字方向 激光强度

<b>产品检测</b>
产品电气性能和气密性进行检测
厂标参数 加压条件

<b>高温老化</b>
高温恒温烘烤加速产品老化，提高产品稳定性
温度 时间

<b>模拟回流焊</b>
模拟客户端回流焊接程，将不良品提前暴露
温度曲线 流程时间

<b>产品压封</b>
在氮气下压封
焊接参数 气密性 露点 IPQC